

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二三年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2024年2月6日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科创板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二三年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二三年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 4.554 億美元，上年同期為 6.301 億美元，上季度為 5.685 億美元。
- 毛利率 4.0%，上年同期為 38.2%，上季度為 16.1%。
- 母公司擁有人應占溢利 3,540 萬美元，上年同期為 1.591 億美元，上季度為 1,390 萬美元。
- 基本每股盈利 0.021 美元，上年同期為 0.122 美元，上季度為 0.009 美元。
- 淨資產收益率（年化）2.4%，上年同期為 22.0%，上季度為 1.2%。

二零二四年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約在 4.5 億美元至 5.0 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 3%至 6%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二三年第四季度以及全年業績評論道：

“華虹半導體二零二三年第四季度銷售收入為 4.554 億美元，單季毛利率為 4.0%，達到指引。二零二三年全年實現銷售收入 22.861 億美元，全年毛利率為 21.3%。”

“2023 年市場形勢低迷，對全球半導體產業來說是極富挑戰的一年。但隨著產業鏈去庫存的持續，以及新一代通信、物聯網等技術的快速滲透，近期半導體市場已出現提振信號，公司與之相關的圖像傳感器、電源管理等產品均在第四季度有較好的表現。為了進一步滿足中長期市場需求，公司加快產能擴充速度，堅持多元化特色工藝平臺技術研發，以提高產品供應能力和市場響應速度。截至二零二三年第四季度末，公司折合八英寸月產能增加到了 39.1 萬片。同時，公司的第二條十二英寸生產線建設也在按計劃推進中，預計將於年底前建成投片。”

唐總繼續講道：“華虹半導體始終堅持技術創新，在研發方面投入了大量資源，積極推進新工藝平臺的研發和現有工藝平臺的優化和提升。此外，公司還積極與國內外上下游企業建立戰略合作，加強產業鏈整合，積極開拓新興市場。在新的一年裡，公司將繼續為客戶提供更優質的技術和服務，聚焦汽車、光伏、消費產品升級等新成長市場，實現可持續發展，鞏固特色工藝晶圓代工領域的領先地位！”

電話會議公告

- 日期 2024 年 2 月 6 日（星期二）
- 時間： 17:00 香港/上海時間
04:00 美國東部時間
- 發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播： 會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/wehhuicp> 作線上直播
(請提前註冊登記)
- 電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN（個人身份識別碼）。

<https://register.vevent.com/register/BI252a25170c124349b8452f07232bd0ad>

重要提示： 在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN（個人身份識別碼）才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN（個人身份識別碼）。
- 網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（A 股簡稱：華虹公司，688347；港股簡稱：華虹半導體，01347）（“本公司”）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略，為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等“8 英寸 + 12 英寸”特色工藝技術的持續創新，有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠，月產能約 18 萬片。另在無錫高新技術產業開發區內建有一座月產能 9.45 萬片的 12 英寸晶圓廠（“華虹無錫”），這不僅是全球領先的 12 英寸特色工藝生產線，也是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。目前，本公司正在推進華虹無錫二期 12 英寸芯片生產線（“華虹製造”）的建設。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	455,361	630,110	568,529	(27.7)%	(19.9)%
毛利	18,220	240,707	91,623	(92.4)%	(80.1)%
毛利率	4.0%	38.2 %	16.1%	(34.2)	(12.1)
經營開支	(95,063)	(59,579)	(85,065)	59.6 %	11.8 %
其他收入/(損失)淨額	87,600	35,565	(19,417)	146.3%	(551.2)%
稅前溢利/(損失)	10,757	216,693	(12,859)	(95.0)%	(183.7)%
所得稅開支	(7,210)	(30,918)	(12,999)	(76.7)%	(44.5)%
期內溢利/(損失)	3,547	185,775	(25,858)	(98.1)%	(113.7)%
淨利潤率	0.8 %	29.5 %	(4.5)%	(28.7)	5.3
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	35,386	159,136	13,890	(77.8)%	154.8 %
非控股權益	(31,839)	26,639	(39,748)	(219.5)%	(19.9)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.021	0.122	0.009	(82.8)%	133.3 %
攤薄	0.021	0.121	0.009	(82.6)%	133.3 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	951	992	1,077	(4.1)%	(11.7)%
產能利用率 ¹	84.1 %	103.2 %	86.8 %	(19.1)	(2.7)
淨資產收益率 ²	2.4 %	22.0 %	1.2 %	(19.6)	1.2

二零二三年第四季度

- 銷售收入 4.554 億美元，上年同期為 6.301 億美元，上季度為 5.685 億美元，主要由於平均銷售價格及付運晶圓下降。
- 毛利率 4.0%，上年同期為 38.2%，上季度為 16.1%，主要由於平均銷售價格下降及產能利用率降低。
- 經營開支 9,510 萬美元，同比上升 59.6%，主要由於研發活動的政府補助減少及工程片開支增加，環比上升 11.8%，主要由於華虹製造人員開支增加。
- 其他收入淨額 8,760 萬美元，同比上升 146.3%，主要由於政府補貼增加，相比上季度為其他損失淨額 1,940 萬美元，主要由於政府補貼增加，以及本季度為外幣匯兌收益上季度為外幣匯兌損失。
- 所得稅開支 720 萬美元，同比下降 76.7%，環比下降 44.5%，主要由於應課稅利潤下降。
- 期內溢利 350 萬美元，上年同期為 1.858 億美元，上季度為期內損失 2,590 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 3,540 萬美元，上年同期為 1.591 億美元，上季度為 1,390 萬美元。
- 基本每股盈利 0.021 美元，上年同期為 0.122 美元，上季度為 0.009 美元。
- 淨資產收益率（年化）2.4%，上年同期為 22.0%，上季度為 1.2%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	2023 (未經審核)	2022 (已審核)	同比
銷售收入	2,286,113	2,475,488	(7.7)%
毛利	487,096	843,656	(42.3)%
毛利率	21.3%	34.1%	(12.8)
經營開支	(333,057)	(279,130)	19.3%
其他收入/(損失)淨額	19,540	(68,456)	(128.5)%
稅前溢利	173,579	496,070	(65.0)%
所得稅開支	(47,154)	(89,499)	(47.3)%
年內溢利	126,425	406,571	(68.9)%
淨利潤率	5.5%	16.4%	(10.9)
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	280,034	449,912	(37.8)%
非控股權益	(153,609)	(43,341)	254.4%
持有人應佔每股盈利			
基本	0.189	0.345	(45.2)%
攤薄	0.188	0.342	(45.0)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	4,103	4,088	0.4%
產能利用率	94.3%	107.4%	(13.1)
淨資產收益率	6.3%	15.2%	(8.9)

二零二三年度

- 銷售收入 22.861 億美元，較上年度下降 7.7%，主要由於平均銷售價格下降。
- 毛利率 21.3%，較上年度下降 12.8 個百分點，主要由於平均銷售價格下降及折舊成本上升，部分被人員開支下降所抵消。
- 經營開支 3.331 億美元，較上年度上升 19.3%，主要由於研發活動的政府補助減少及研發工程片開支上升。
- 其他收入淨額 1,950 萬美元，上年度為其他損失淨額 6,850 萬美元，主要由於外幣匯兌損失減少，政府補貼及利息收入增加，部分被財務費用上升所抵消。
- 年內溢利 1.264 億美元，上年度為 4.066 億美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 2.800 億美元，上年度為 4.499 億美元。
- 基本每股盈利 0.189 美元，上年度為 0.345 美元。
- 淨資產收益率 6.3%，上年度為 15.2%。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	436,375	95.8 %	602,591	95.6 %	(166,216)	(27.6)%
其他	18,986	4.2 %	27,519	4.4 %	(8,533)	(31.0)%
銷售收入總額	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度 95.8%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	250,743	55.1 %	397,513	63.1 %	(146,770)	(36.9)%
12 吋晶圓	204,618	44.9 %	232,597	36.9 %	(27,979)	(12.0)%
銷售收入總額	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.507 億美元及 2.046 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	366,508	80.5 %	456,876	72.6 %	(90,368)	(19.8)%
北美 ⁴	36,811	8.1 %	85,956	13.6 %	(49,145)	(57.2)%
亞洲 ⁵	30,176	6.6 %	42,055	6.7 %	(11,879)	(28.2)%
歐洲	18,475	4.1 %	33,690	5.3 %	(15,215)	(45.2)%
日本 ⁶	3,391	0.7 %	11,533	1.8 %	(8,142)	(70.6)%
銷售收入總額	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 3.665 億美元，占銷售收入總額的 80.5%，同比下降 19.8%，主要由於 MCU、智能卡芯片、超級結和 NOR flash 產品需求減少，部分被 IGBT 及 CIS 產品需求增加所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 3,680 萬美元，同比下降 57.2%，主要由於 MCU 及其他電源管理產品的需求減少。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,020 萬美元，同比下降 28.2%，主要由於 MCU 產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,850 萬美元，同比下降 45.2%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 340 萬美元，同比下降 70.6%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	112,026	24.6 %	236,281	37.5 %	(124,255)	(52.6)%
獨立式非易失性存儲器	14,753	3.2 %	36,557	5.8 %	(21,804)	(59.6)%
分立器件	182,377	40.2 %	212,972	33.8 %	(30,595)	(14.4)%
邏輯及射頻	56,227	12.3 %	42,942	6.8 %	13,285	30.9 %
模擬與電源管理	89,448	19.6 %	100,940	16.0 %	(11,492)	(11.4)%
其他	530	0.1 %	418	0.1 %	112	26.8 %
銷售收入總額	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.120 億美元，同比下降 52.6%，主要由於 MCU 及智能卡芯片的需求減少。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 1,480 萬美元，同比下降 59.6%，主要由於 NOR flash 產品的需求減少。
- 本季度分立器件銷售收入 1.824 億美元，同比下降 14.4%，主要由於通用 MOSFET 及超級結產品的需求減少，部分被 IGBT 產品需求增加所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 5,620 萬美元，同比增長 30.9%，主要得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 8,940 萬美元，同比下降 11.4%，主要由於其他電源管理及模擬產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	60,920	13.4 %	59,244	9.4 %	1,676	2.8 %
90nm 及 95nm	82,552	18.1 %	124,450	19.8 %	(41,898)	(33.7)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	73,762	16.2 %	126,128	20.0 %	(52,366)	(41.5)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	31,049	6.8 %	56,227	8.9 %	(25,178)	(44.8)%
0.25 μ m	5,357	1.2 %	4,153	0.7 %	1,204	29.0 %
0.35 μ m 及以上	201,721	44.3 %	259,908	41.2 %	(58,187)	(22.4)%
銷售收入總額	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 6,090 萬美元，同比增長 2.8%，主要得益於 CIS 及模擬產品的需求增加，大部分被 NOR flash 及 MCU 產品的需求減少所抵消。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 8,260 萬美元，同比下降 33.7%，主要由於智能卡芯片及 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 7,380 萬美元，同比下降 41.5%，主要由於 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,100 萬美元，同比下降 44.8%，主要由於 MCU 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 540 萬美元，同比增長 29.0%，主要得益於射頻產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.017 億美元，同比下降 22.4%，主要由於超級結、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求減少。

銷售收入分析

按終端市場分佈 劃分的銷售收入	二零二三年	二零二三年	二零二二年	二零二二年	同比	同比
	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	仟美元	%
電子消費品	252,508	55.4 %	390,993	62.1 %	(138,485)	(35.4)%
工業及汽車	138,628	30.4 %	169,571	26.9 %	(30,943)	(18.2)%
通訊	53,973	11.9 %	50,632	8.0 %	3,341	6.6 %
計算機	10,252	2.3 %	18,914	3.0 %	(8,662)	(45.8)%
銷售收入總額	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 2.525 億美元，占銷售收入總額的 55.4%，同比下降 35.4%，主要由於 MCU、超級結、NOR flash、智能卡芯片、及通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.386 億美元，同比下降 18.2%，主要由於 MCU、智能卡芯片、及通用 MOSFET 產品的需求減少，部分被 IGBT 產品需求增加所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 5,400 萬美元，同比增長 6.6%，主要得益於 CIS 及模擬產品需求增加，部分被智能卡芯片需求減少所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,030 萬美元，同比下降 45.8%，主要由於通用 MOSFET 及 MCU 產品需求減少。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(折合 8 吋片晶圓)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	95	65	80
合計產能	391	324	358
產能利用率 (200mm)	91.0%	105.9%	95.3%
產能利用率 (300mm)	77.5%	99.9%	78.4%
總體產能利用率	84.1%	103.2%	86.8%

- 本季度末月產能 391,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 84.1%。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	951	992	1,077	(4.1)%	(11.7)%

- 本季度付運晶圓 951,000 片，同比下降 4.1%，環比下降 11.7%。

經營開支分析

以仟美元計	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,684	2,914	2,415	(7.9)%	11.1 %
管理費用 ⁸	92,379	56,665	82,650	63.0 %	11.8 %
經營開支	95,063	59,579	85,065	59.6 %	11.8 %

- 經營開支 9,510 萬美元，同比上升 59.6%，主要由於研發活動的政府補助減少及工程片開支增加，環比上升 11.8%，主要由於華虹製造人員開支增加。

其他收入/(損失)淨額

以仟美元計	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,447	3,352	3,428	2.8 %	0.6 %
利息收入	20,182	10,775	15,742	87.3 %	28.2 %
匯兌收益/(損失)	27,041	22,054	(13,986)	22.6 %	(293.3)%
分佔聯營公司溢利/(損失)	7,136	7,311	(1,410)	(2.4)%	(606.1)%
財務費用	(19,540)	(8,465)	(24,257)	130.8 %	(19.4)%
政府補貼	51,387	678	77	7,479.2 %	66,636.4 %
其他	(2,053)	(140)	989	1,366.4 %	(307.6)%
其他收入/(損失)淨額	87,600	35,565	(19,417)	146.3 %	(551.2)%

- 其他收入淨額 8,760 萬美元，同比上升 146.3%，主要由於政府補貼增加，相比上季度為其他損失淨額 1,940 萬美元，主要由於政府補貼增加，以及本季度為外幣匯兌收益上季度為外幣匯兌損失。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	196,546	184,413	152,091	6.6 %	29.2 %
投資活動所用現金流量淨額	(301,916)	(303,135)	(177,466)	(0.4)%	70.1 %
融資活動所得現金流量淨額	642,297	120,141	3,176,383	434.6 %	(79.8)%
外匯匯率變動影響淨額	58,753	23,118	(12,464)	154.1 %	(571.4)%
現金及現金等價物變動影響淨額	595,680	24,537	3,138,544	2,327.7 %	(81.0)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.965 億美元，同比上升 6.6%，環比上升 29.2%，主要由於政府補助增加及人員開支減少。
- 投資活動所用現金流量淨額 3.019 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 3.314 億美元，部分被收到利息收入 1,780 萬美元及收到政府對設備的補助 1,170 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 6.423 億美元，其中非控股權益資本注資 4.917 億美元，提取銀行借款 2.466 億美元，收到政府對財務費用的補助 300 萬美元，員工行權發行股份收到 140 萬美元，部分被償還銀行借款 5,490 萬美元，支付利息 4,520 萬美元，及支付租賃負債 30 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)
資產總額	10,943,420	9,974,339
負債總額	2,928,876	2,642,094
所有者權益總額	8,014,544	7,332,245
資產負債率 ⁹	26.8%	26.5%

資本開支

以仟美元計	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)
華虹 8 吋	28,761	22,795
華虹無錫	121,918	111,827
華虹製造	180,690	59,030
合計	331,369	193,652

- 本季度資本開支 3.314 億美元，其中 1.219 億美元用於華虹無錫，1.807 億美元用於華虹製造，及 2,880 萬美元用於華虹 8 吋。

⁹資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)
發展中物業	178,828	157,230
存貨	449,749	492,783
貿易應收款項及應收票據	278,669	318,787
預付款項、其他應收款項及其他資產	33,821	34,168
應收關聯方款項	11,219	19,572
已凍結存款及定期存款	32,088	31,654
現金及現金等價物	5,585,181	4,989,501
流動資產總額	6,569,555	6,043,695
貿易應付款項	235,410	213,530
其他應付款項及暫估費用	428,512	357,181
計息銀行借款	193,035	180,238
租賃負債	3,076	3,281
政府補助	35,017	34,321
應付關聯方款項	13,876	4,604
應付所得稅	61,495	57,885
流動負債總額	970,421	851,040
淨營運資金	5,599,134	5,192,655
速動比率	6.1x	6.3x
流動比率	6.8x	7.1x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	60	50
存貨周轉天數	97	99

- 存貨由上季度末的 4.928 億美元下降至本季度末的 4.498 億美元，主要由於原材料及產成品的減少。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 3.188 億美元下降至本季度末的 2.787 億美元，主要由於銷售收入下降。
- 現金及現金等價物由上季度末的 49.895 億美元上升至本季度末的 55.852 億美元，主要由於前述現金流量分析中闡述的原因。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 3.572 億美元上升至本季度末的 4.285 億美元，主要由於應付資本開支款增加。
- 淨營運資金 本季度末 55.991 億美元，流動比率 6.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 60 天。
- 存貨周轉天數 97 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)
銷售收入	455,361	630,110	568,529
銷售成本	(437,141)	(389,403)	(476,906)
毛利	18,220	240,707	91,623
其他收入及收益	100,442	37,090	20,290
投資物業的公平值收益	103	394	-
銷售及分銷費用	(2,684)	(2,914)	(2,415)
管理費用	(92,379)	(56,665)	(82,650)
其他費用	(541)	(765)	(14,040)
財務費用	(19,540)	(8,465)	(24,257)
分佔聯營公司溢利/(損失)	7,136	7,311	(1,410)
稅前溢利/(損失)	10,757	216,693	(12,859)
所得稅開支	(7,210)	(30,918)	(12,999)
期內溢利/(損失)	3,547	185,775	(25,858)
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	35,386	159,136	13,890
非控股權益	(31,839)	26,639	(39,748)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.021	0.122	0.009
攤薄	0.021	0.121	0.009
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,716,439,808	1,306,626,546	1,580,159,540
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,720,215,394	1,314,496,496	1,587,083,357

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	二零二三年 (未經審核)	二零二二年 (已審核)
銷售收入	2,286,113	2,475,488
銷售成本	(1,799,017)	(1,631,832)
毛利	487,096	843,656
其他收入及收益	144,370	70,986
投資物業的公平值收益	103	78
銷售及分銷費用	(10,189)	(12,464)
管理費用	(322,868)	(266,666)
其他費用	(33,666)	(111,360)
財務費用	(100,497)	(40,331)
分佔聯營公司溢利	9,230	12,171
稅前溢利	173,579	496,070
所得稅開支	(47,154)	(89,499)
年內溢利	126,425	406,571
以下各方應佔利潤		
母公司擁有人	280,034	449,912
非控股權益	(153,609)	(43,341)
持有人應佔每股盈利		
基本	0.189	0.345
攤薄	0.188	0.342
用於計算持有人應佔每股基本盈利的年內已發行普通股加權平均數	1,477,978,482	1,303,399,389
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的年內已發行普通股加權平均數	1,486,531,954	1,313,945,277

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,519,292	3,322,946	3,367,716
投資物業	166,643	164,287	169,363
使用權資產	78,545	79,070	78,425
無形資產	49,827	29,182	32,986
於聯營公司的投資	139,099	128,833	130,721
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	270,506	153,024	178,632
長期預付款項	149,953	36,085	7,742
遞延稅項資產	-	17,217	14,066
非流動資產總額	4,373,865	3,930,644	3,979,651
流動資產			
發展中物業	178,828	157,230	134,723
存貨	449,749	492,783	578,060
貿易應收款項及應收票據	278,669	318,787	291,856
預付款項、其他應收款項及其他資產	33,821	34,168	48,273
應收關聯方款項	11,219	19,572	13,006
已凍結存款及定期存款	32,088	31,654	1,042
現金及現金等價物	5,585,181	4,989,501	2,008,765
流動資產總額	6,569,555	6,043,695	3,075,725
流動負債			
貿易應付款項	235,410	213,530	236,999
其他應付款項及暫估費用	428,512	357,181	593,971
計息銀行借款	193,035	180,238	426,756
租賃負債	3,076	3,281	4,704
政府補助	35,017	34,321	37,714
應付關聯方款項	13,876	4,604	6,096
應付所得稅	61,495	57,885	76,176
流動負債總額	970,421	851,040	1,382,416
流動資產淨額	5,599,134	5,192,655	1,693,309
總資產減流動負債	9,972,999	9,123,299	5,672,960
非流動負債			
計息銀行借款	1,906,526	1,745,779	1,481,580
租賃負債	19,129	18,650	14,644
遞延稅項負債	30,834	26,625	41,268
僱員福利負債	1,966	-	-
非流動負債總額	1,958,455	1,791,054	1,537,492
淨資產	8,014,544	7,332,245	4,135,468
權益和負債權益			
股本	4,933,559	4,932,673	1,994,462
儲備	1,367,436	1,164,151	1,036,008
本公司擁有人應佔權益	6,300,995	6,096,824	3,030,470
非控股權益	1,713,549	1,235,421	1,104,998
權益總額	8,014,544	7,332,245	4,135,468

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利/(虧損)	10,757	216,693	(12,859)
折舊及攤銷	129,135	107,849	127,305
應佔聯營公司(溢利)/虧損	(7,136)	(7,311)	1,410
營運資金的變動及其它	63,790	(132,818)	36,235
經營活動所得現金流量淨額	196,546	184,413	152,091
投資活動所用現金流量：			
購置物業、廠房、設備及無形資產項目	(331,369)	(331,065)	(193,652)
投資聯營公司	-	(4,013)	-
收到政府對物業、廠房及設備的補助	11,692	24,655	-
其他投資活動所得現金流量	17,761	7,288	16,186
投資活動所用現金流量淨額	(301,916)	(303,135)	(177,466)
融資活動所得現金流量：			
非控股權益資本注資	491,723	-	-
提取銀行貸款	246,620	181,470	347,707
償還銀行貸款	(54,942)	(39,826)	(239,086)
已付利息	(45,234)	(31,861)	(3,803)
支付租賃負債	(274)	(782)	(1,230)
發行股份所得收益	1,407	1,631	2,937,689
受限制貨幣資金減少	-	-	136,524
其他融資活動所得/(用)現金流量	2,997	9,509	(1,418)
融資活動所得現金流量淨額	642,297	120,141	3,176,383
現金及現金等價物增加淨額	536,927	1,419	3,151,008
外匯匯率變動影響淨額	58,753	23,118	(12,464)
期初現金及現金等價物	4,989,501	1,984,228	1,850,957
期末現金及現金等價物	5,585,181	2,008,765	4,989,501

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	二零二三年 (未經審核)	二零二二年 (已審核)
經營活動所得現金流量：		
稅前溢利	173,579	496,070
折舊及攤銷	500,439	456,860
應佔聯營公司溢利	(9,230)	(12,171)
營運資金的變動及其它	(23,093)	(189,894)
經營活動所得現金流量淨額	641,695	750,865
投資活動所用現金流量：		
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(906,607)	(996,182)
投資聯營公司	-	(6,717)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	11,692	38,414
其他投資活動所得現金流量	61,603	34,329
投資活動所用現金流量淨額	(833,312)	(930,156)
融資活動所得現金流量：		
發行股份所得收益	2,941,945	6,248
非控股權益資本注資	787,920	392,000
提取銀行貸款	615,415	514,622
償還銀行貸款	(422,120)	(199,670)
已付利息	(106,570)	(47,286)
受限制貨幣資金增加	(31,214)	-
支付租賃負債	(4,597)	(3,246)
其他融資活動所得現金流量	967	9,509
融資活動所得現金流量淨額	3,781,746	672,177
現金及現金等價物增加淨額	3,590,129	492,886
外匯匯率變動影響淨額	(13,713)	(94,261)
期初現金及現金等價物	2,008,765	1,610,140
期末現金及現金等價物	5,585,181	2,008,765

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

葉峻

周利民

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事会命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二四年二月六日